



## SMD 接地弾片 / OG-232242

产品页



OG-232242

传统产品

### 省空间型接地部件

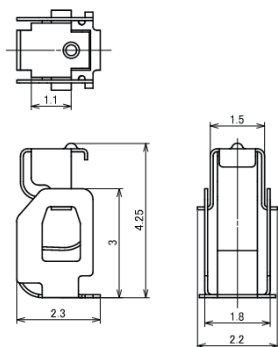
- 与传统产品相比，贴片面积减少至原来的1/3。
- 有助于装置的小型化。
- 可在噪声源附近接地。
- 可用于对策因电路板和外壳(散热片)之间形成的平行板共振而产生的辐射噪声。
- 使用范围: 产品高度3.2~3.8毫米(推荐)
- 标准包装数量 2500个/卷

### 规格

主要用途	接地用SMD弹片
建议使用范围	3.2mm ~ 3.8mm
使用材料	弹簧用磷青铜
表面处理	Sn回流电镀 (基底镀铜)
建议使用温度范围	-40°C ~ 125°C

### 产品尺寸

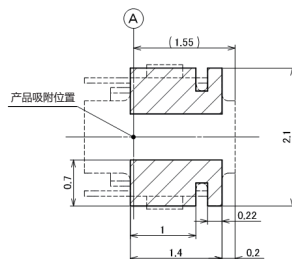
(单位: mm)



### 推荐印刷电路板设计

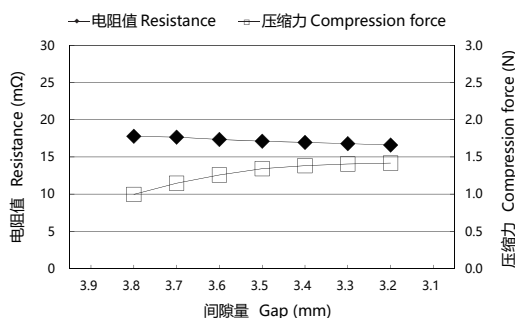
(单位: mm)

<焊盘和掩膜尺寸>



### 特性

#### ● 压缩电阻特性



- 规格及特性为代表性的值，并非保证值。可能会因性能提升及规格变更而发生变化，恕不另行通知。
- 未经本公司书面事先同意，不得转载记述内容。

### 使用实例

显示器、摄像头模组、汽车导航系统、IVI、投影仪等图像系统

